

会社の概況 (平成30年3月31日現在)

商号	信越ポリマー株式会社 (Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd.)
本社所在地	東京都千代田区神田須田町一丁目9番地
設立年月日	昭和35年9月15日
資本金	11,635,953,759円
従業員数	1,019名(連結4,407名)
支店・営業所	大阪支店、名古屋支店、福岡支店、 仙台営業所、広島営業所、札幌営業所
工場	東京工場、児玉工場(以上、埼玉県)、 南陽工場(山口県)、塩尻工場、 長野分工場(以上、長野県)、 糸魚川工場(新潟県)

株式の状況	
発行可能株式総数	320,000,000株
発行済株式総数	82,623,376株
株主数	9,239名

株主の皆様のお声を聞かせください

当社では、株主の皆様のお声を聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記URLにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示されるアンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

 <http://www.e-kabunushi.com>
アクセスコード 7970

いいかぶ

検索

 空メールによりURL自動返信

kabu@wjim.jpへ空メールを送信してください。(タイトル、本文は無記入)
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

●アンケート実施期間は、本書がお手元に到着してから約2ヶ月間です。

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝(図書カード500円)
を呈呈させていただきます

 ※本アンケートは、株式会社 a2media(イー・ツー・メディア)の提供する「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。
(株式会社 a2media)についての詳細<http://www.a2media.co.jp>
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただきます。事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

●アンケートのお問い合わせ TEL:03-5777-3900(平日 10:00~17:30)
「e-株主リサーチ事務局」 MAIL:info@e-kabunushi.com

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
剰余金の配当基準日	3月31日(中間配当を行う場合は9月30日)
定時株主総会	毎年6月
単元株式数	100株
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号
特別口座管理機関	みずほ信託銀行株式会社
公告方法	電子公告(https://www.shinpoly.co.jp/) なお、やむを得ない事由によって、電子公告 によることができない場合には、日本経済新聞 に掲載して行います。

株式に関するお手续

	証券会社等に口座を お持ちの場合	証券会社等に口座をお持ちでない場合 (特別口座の場合)
郵便物 送付先		〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 お問合せ先		フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)
各種手続 お取扱店 (住所変更、 株主配当金 受取方法 の変更等)	お取引の証券会社等になります。	みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 *トラストラウンジでは、お取扱 できませんのでご了承ください。 みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店 ブラネットブース(株式会社み ずほ銀行内の店舗)でもお取扱 いたします。
未払配当金 のお支払	みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 株式会社みずほ銀行 本店及び全国各支店 (みずほ証券株式会社では、取次のみとなります。)	
ご注意	支払明細発行については、 右の「特別口座の場合」 の郵便物送付先・電話お 問合せ先・各種手続お取 扱店をご利用ください。	特別口座では、単元未満株式の買 取・買増以外の株式売買はできませ ん。証券会社等に口座を開設し、株 式の振替手続を行っていただく必要 があります。

単元未満株式買増・買取のご案内

当社では、単元未満株式(1株から99株まで)の買増制度・買取制度を導入しておりますので、ご利用ください。
お手続の詳細は、上記記載のお取扱店にお問い合わせください。

ShinEtsu

信越ポリマー株式会社

第58期 報告書

平成29年4月1日~平成30年3月31日



信越ポリマー株式会社

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町1-9

電話 (03) 5289-3712

ホームページアドレス <https://www.shinpoly.co.jp/>



UD
FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

証券コード:7970

株主の皆様へ



代表取締役社長 小野 義昭

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ここに、当社グループの第58期連結会計年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の事業の概況等をご報告申し上げます。

当連結会計年度の業績は、売上高793億43百万円（前期比7.3%増）、営業利益72億6百万円（前期比30.7%増）、経常利益72億74百万円（前期比22.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益54億55百万円（前期比28.9%増）となりました。

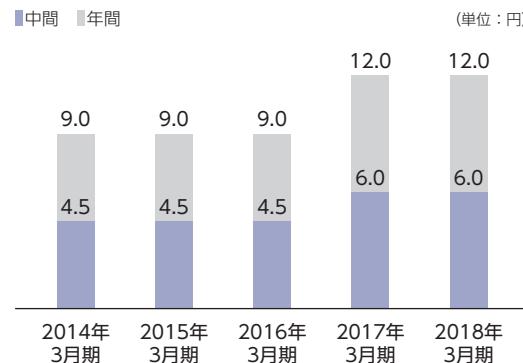
当期の期末配当金につきましては、業績及び今後の事業展開等を総合的に勘案し、1株につき6円とさせていただきます。

これにより、中間配当金6円を加えた年間配当金は、1株につき12円となります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。

平成30年6月

配当金の推移



事業の概況

当連結会計年度における世界経済は、先進国を中心に緩やかな景気回復基調が続きました。米国においては、政権の政策に不透明感があつたものの、個人消費は底堅く推移し、企業収益も改善するなど景気回復が続く、欧州においても金融緩和策や新興国経済の持ち直しなどが下支えとなり、緩やかな景気回復傾向にありました。また、アジアにおいては、中国では経済政策の効果もあり景気は減速から安定に向かい、ASEAN諸国では回復傾向にありました。

日本経済は、概ね円安基調が続き、企業収益の改善や、堅調な雇用・所得環境を背景に個人消費も底堅く、緩やかな景気回復が続きました。

当社グループ関連の事業環境につきましては、半導体業界の活況が継続し、自動車関連分野の需要も順調に推移しました。

このような状況のもと、当社グループは国内外において主力製品及び新規事業製品の拡販に注力した営業活動を継続的に展開してまいりました。また、期初に国内生産子会社4社を吸収合併して経営資源を集約するとともに、国内外の生産能力増強など積極的な設備投資をしてまいりました。

今後につきましては、当社グループの事業領域である電気・電子機器、半導体業界等では、お客様の生産動向、競合他社との競争激化など事業環境の先行きが不透明であり、予断を許さない状況にありますが、世界市場の需要の伸びを的確にとらえた販売活動と、最適地生産を徹底して、グローバルな事業展開を加速させてまいります。

また、当社グループは、安全第一に、地球環境保全、コンプライアンスなどの企業の社会的責任をより一層果たすべく、CSR経営を推し進めるとともに、コーポレートガバナンスの充実及びリスク管理に万全を期し、企業体質の強化と企業価値の向上に努めてまいります。

連結業績ハイライト



業績についての詳細はこちらをご覧ください

⇒ <https://www.shinpoly.co.jp/ir/highlight.html>

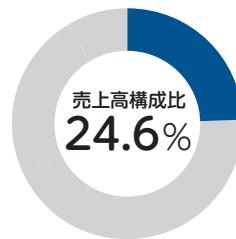


電子デバイス事業

売上高
19,554百万円
(前期比4.9%増)

自動車関連入力デバイスの順調な出荷により増収増益

自動車関連入力デバイスを中心に順調な出荷が続き、全体として売上げは前年度を上回り、利益は大幅に伸ばしました。この結果、当事業の売上高は195億54百万円（前期比4.9%増）、営業利益は15億29百万円（前期比29.3%増）となりました。

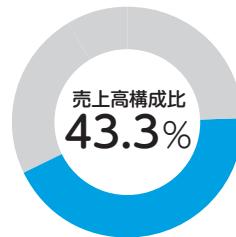


精密成形品事業

売上高
34,369百万円
(前期比10.6%増)

半導体関連容器の出荷が伸ばして増収増益

半導体関連容器の出荷が好調に推移し、全体として売上げは前年度を上回り、利益も伸びました。この結果、当事業の売上高は343億69百万円（前期比10.6%増）、営業利益は50億57百万円（前期比12.3%増）となりました。

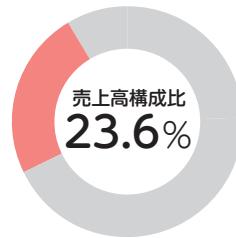


住環境・生活資材事業

売上高
18,703百万円
(前期比8.3%増)

塩ビパイプ関連製品の受注量の確保や、機能性コンパウンドの好調な推移により、増収増益

市場環境が厳しい中、塩ビパイプ関連製品の受注確保、機能性コンパウンドの出荷好調並びに生産効率化や新規事業製品拡販などにより、全体として売上げは前年度を上回り、黒字転換しました。この結果、当事業の売上高は187億3百万円（前期比8.3%増）、営業利益は4億48百万円（前期は1億16百万円の損失）となりました。

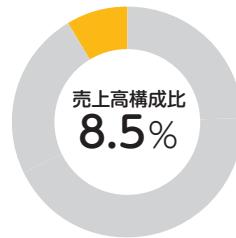


その他

売上高
6,715百万円
(前期比3.9%減)

工事関連の安定受注に努めたが減収

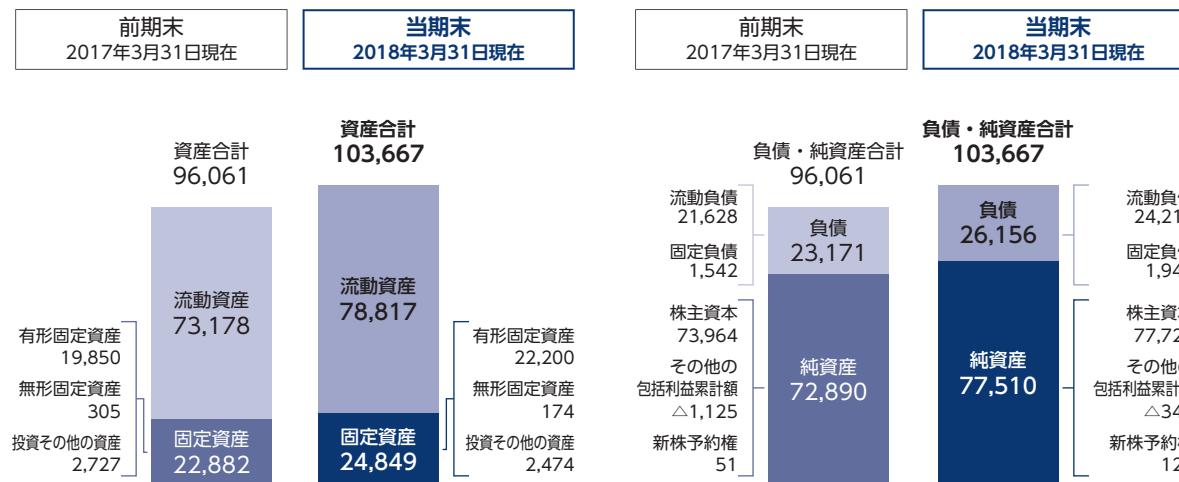
工事関連では、首都圏を中心に商業施設の新築・改装物件、公共施設の内装物件の安定的な受注に努めましたが、全体として、売上げは前年度を下回りました。この結果、その他の売上高は67億15百万円（前期比3.9%減）、営業利益は1億71百万円（前期は58百万円の損失）となりました。



連結財務諸表の概況

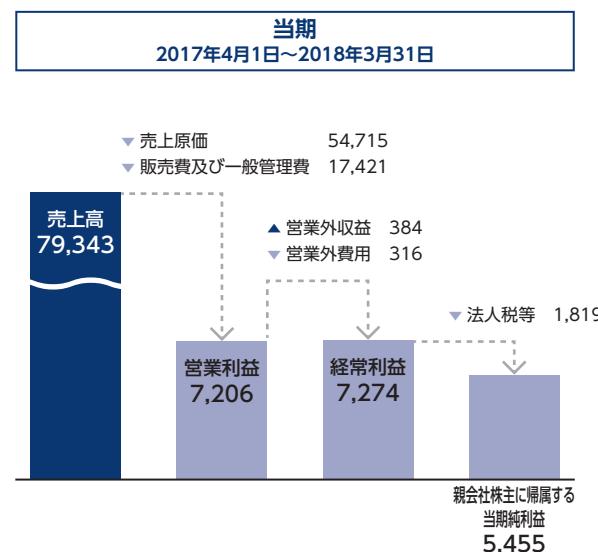
連結貸借対照表の概要

(百万円)



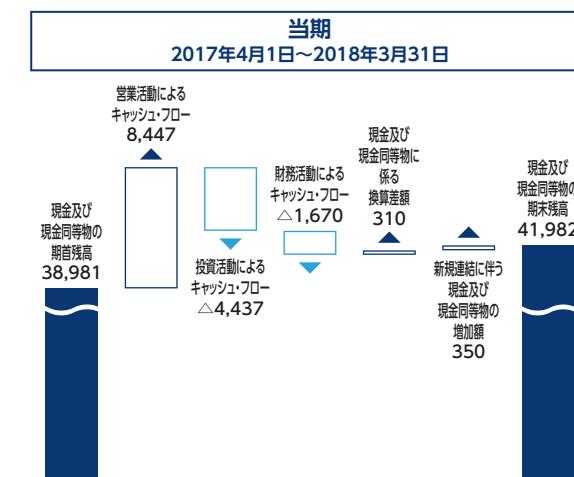
連結損益計算書の概要

(百万円)



連結キャッシュ・フロー計算書の概要

(百万円)



トピックス

配管の防食メンテナンスに用いるシリコン資材 金属腐食を長期間ストップさせるテープ「サビ御用」を発売

当社は、一昨年から東日本旅客鉄道株式会社様とインフラメンテナンス向けシリコン加工品の応用展開について共同研究開発を進めてきました。その研究成果の一つである配管などの金属腐食を長期間ストップさせる自己融着性防食クリアテープ「サビ御用」（東日本旅客鉄道株式会社様と特許共同出願中）を4月10日から発売しています。

「サビ御用」は、シリコンの特長である自己融着性（シリコン素材同士が融着し一体化する性質）を活かすことで、配管に巻きつけるだけで配管の腐食を予防することができ、また、粘着剤を使用していないため、剥がしても糊残りのないテープです。

今後も、屋内外に設置されているインフラの老朽化対策として、メンテナンスに求められる補修資材を提案していきます。



耐候性、耐寒性に優れたシリコンゴムを用いて、配管接続部の腐食防止用に開発されたテープ「サビ御用」

台湾に販売拠点を設立



当社の100%子会社であるShin-Etsu Polymer Hong Kong Co.,Ltd.が台湾の半導体開発企業やIT企業が集積している台北市内に支店を開設し、4月1日から営業を開始しました。台北支店では、半導体メーカー全般に対して、主力製品の一つである半導体関連容器・キャリアテープ関連製品などを販売するほか、FOWLPなどの次世代半導体技術に対応する開発テーマの発掘にも取り組めます。また、モバイル機器やパソコンなどのセットメーカーに対しては、入力デバイスなどの企画・設計に密着したサービスや製品を提供します。

(注) FOWLP (Fan Out Wafer Level Package) とは、ICチップ上の微細な配線を、チップの外形より外側に拡張されるプリント基板で再配線し、従来のパッケージと比較して大幅な小型・薄型化を実現するパッケージの一形態。

台北支店が入居しているビル

当社グループ「サステナビリティレポート2017」が 第21回「環境コミュニケーション大賞」で優良賞を受賞

当社グループの「サステナビリティレポート2017」が第21回「環境コミュニケーション大賞」（主催：環境省、一般財団法人地球・人間環境フォーラム）で「環境報告書部門 優良賞」を受賞いたしました。「環境・社会報告書2015」に続いて2回目の表彰となりました。

「環境コミュニケーション大賞」とは、優れた環境報告書などを表彰し、企業の環境コミュニケーションへの取り組みを促進するとともに情報の質の向上を図ることを目的とした制度です。

当社グループでは、2000年から「環境面を切り口とする生産性向上活動」として、**「グリーン運動」**に取り組む、継続的に情報を開示しています。



表題を従来の「環境・社会報告書」から「サステナビリティレポート」に変更し、持続可能な社会の実現のための活動内容を報告しております。

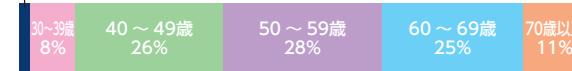
株主アンケート結果報告

第58期第2四半期報告書においてお願いいたしました「株主アンケート」に多くの株主の皆様からのご回答を頂戴いたしました。心からお礼申し上げます。株主の皆様からいただきましたご回答内容を真摯に受け止め、今後の本報告書の充実、またSR・IR活動に活かしてまいります。

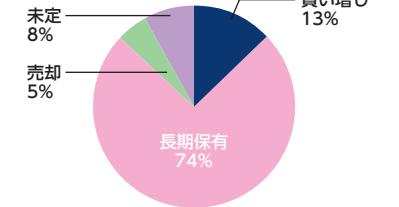
Q.性別



Q.年齢



Q.株式に関する方針



皆様のご意見に関する当社の回答

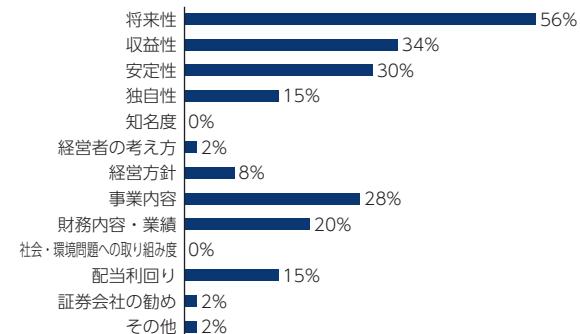
Q 電子デバイス事業の自動車関連入力デバイスの商品内容がもう少し詳しく知りたかった。

A 自動車関連入力デバイスには、主に、キースイッチ及びタッチスイッチの2種類があります。自動車用のキースイッチは、シリコンゴムを素材とした製品であり、高い信頼性が要求され、それに応え続けることで、業界トップの評価を得ております。また、最近では、ステアリングスイッチやリモートキーとしての採用が増加しております。一方、タッチスイッチは、フィルム状の製品であり、自社開発の透明な導電性ポリマーなどを高精細印刷技術で電極形成した、静電容量方式の新しい入力デバイスとして、カーナビ機器や自動車用のエアコンのスイッチとして採用が進んでおります。

Q AIが進み、電子部品等が伸び、増収・増益を期待しています。時節に遅れないよう頑張ってください。

A AI化や自動車の電子化の進展により、半導体や電子部品等の使用量が增大することが、当社の電子デバイス関連製品及び精密成形品関連製品に、直接的・間接的に影響しております。当社としては、これまでこのような市場の動きに追随した事業展開を積極的に進めており、今後もトレンドに合わせた事業展開に取り組んでまいります。

Q.当社の株式を購入された理由は（複数回答）



Q.今後、充実を希望する情報は（複数回答）

